

中标公告

厦门集成电路晶圆测试公共服务平台提升（晶圆测试平台扩产）项目场地设计招标工作于 2021 年 9 月 6 日在万翔商务中心 2 号楼南楼 12 层厦门科技产业化集团有限公司会议室评标结束。

经确认，本次评标结果公布如下：

中标单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

中标价：45 万元

设计周期：48 个工作日

如对评标结果有异议，请于本评标结果公布之日起 3 个工作日内以书面形式向厦门科技产业化集团有限公司提出质疑。

感谢各投标单位对本次招标活动的积极参与！

招标单位：厦门科技产业化集团有限公司

联系地址：万翔商务中心 2 号楼南楼 12 层

联系人：张晓虹

电话：0592-2529617

传真：0592-2529507

厦门科技产业化集团有限公司

2021 年 9 月 6 日

